산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 6. 28.(금) 02:00 < 6.28.(금) 조간 > 배포 2024. 6. 27.(목)

반도체 민관 협력 강화를 위한 「한-미 공급망·산업대화 반도체 포럼」 열려

- 산업부 장관, 미국 상무장관, 양국 반도체 기업인 및 연구계 인사 참석
- 연구개발(R&D), 인력양성, 공급망 등 양국 반도체 산업 현안 공조방안 논의

산업통상자원부(이하 산업부) 안덕근 장관은 지나 러몬도(Gina Raimondo) 미국 상무부 장관과 함께 6.27.(목) 미국 워싱턴 D.C.에서 한-미 양국 반도체협회가 공동 주최하는 「한-미 공급망·산업 대화(SCCD) 반도체 포럼」에 참석하였다. 작년 4월 미국 국빈 방문 계기 개최된 「제1차 한-미 공급망·산업 대화」에서 산업부 장관과 미 상무부 장관은 양국 반도체 협력 강화를 위하여 민관이 참여하는 동 포럼 설치에 합의하였다.

* SCCD(Supply Chain and Commercial Dialogue) : '22.5월 美 바이든 대통령 방한 계기에 설치 합의한 첨단산업 및 공급망 협력 채널

동 포럼에는 산업부·미(美)상무부와 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, IBM, 시놉시스, 산기평, KIAT, Invest Korea 등 양국 주요 반도체 기업 및 기관에서 참석하였다. 참석자들은 양국 반도체 산업 현안인 △기술개발, △인력양성, △공급망 안정에 대하여 현황을 점검하고 동 분야에서의 양국간 협력 강화방안을 논의하였다.

한편, 양국 반도체 협회는 반도체 공급망 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 반도체 포럼의 정례화와 인공지능(AI) 등 신흥 시장에서의 비즈니스 협력, 기술개발·인력양성·투자 활성화 등을 위한 협력을 추진하기로 하였다.

안덕근 장관은 개회사를 통하여 "글로벌 연구개발(R&D) 투자 확대 및 신설된 「한-미 산업기술 협력센터*」를 통해 양국 간 기술 협력을 지원하는 한편, 석박사·청년 인력 교류 확대를 통한 인력 부족 문제를 공조하겠다"고 밝히면서, "올 하반기 미국 현지에 설립될 「한-미 인공지능(AI) 반도체 혁신센터**」가 양국 산업계 교류 활성화에 기여하고 동 반도체 포럼도 양국 민관간 자유로운 소통의 장이 되기를 기대한다"고 언급하였다.

* 차세대 산업원천기술 확보를 위해 해외 최우수 연구기관과의 공동 R&D 확대·인력교류를 지원하는 국제협력 채널(미국 내 예일, 조지아텍, 존스홉킨스, 퍼듀 등 4개소 개소)

** 우리 시스템반도체 기업의 美시장 진출을 지원하기 위해 '24.3분기 美산호세 개소 예정

담당 부서 <총괄>	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	정은지 (044-203-4273)
		담당자	사무관	최원석 (044-203-4142)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 「한-미 공급망·산업 대화 반도체 포럼」 개요

□ 행사명 : 「한-미 공급망·산업 대화 반도체 포럼」
(U.S.-Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Semiconductor Forum)

□ 일시 /장소 : 6.27(목) 13:00~16:30 / 워싱턴 D.C. 더 헤이아담스 호텔

□ 참석자 : 양국 정부 관계자 및 기업·기관 대표 등 60여명

○ 우리측 : 산업부 장관, 한국반도체산업협회, 한국산업기술기획평가원, 한국산업기술진흥원, Invest Korea, 한국반도체아카데미, 삼성전자, SK하이닉스 등 30여명

○ 미 측 : 상무부 장관, 美반도체산업협회, CHIPS Program Office, 국립반도체기술센터(NSTC), 인텔, IBM, 시놉시스, 암페어 컴퓨팅(Ampere Computing) 등 30여명

□ 세부 일정 * 개회식 및 주제발표 공개

시간	주요 내용	비고
13:00~13:20 (20′)	**개회식**	
	개회사	산업부 장관 美상무장관
	양국 협회간 공급망 협력 MOU	양국 반도체 협회
	기념촬영	주요 참석자
13:20~13:40 (20′)	**주제 발표**	
	양국 협회간 협력방안	양국 반도체 협회
13:40-16:15 (155′)	**세션별 패널 토론**	
	① R&D	산업부, 美상무부, 양국 반도체 협회, 연구기관·기업 등
	② 인력양성	
	③ 공급망	
16:15~16:30 (15′)	**폐회**	산업부, 美상무부, 양국 반도체 협회